

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	西南证券 胡光悻、戚欣龙；银河基金 傅鑫、金焯；西部证券 郭义俊；浙商证券 张致远；
时间	2026年05月21日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书 钟科 证券事务代表 潘露璐 证券事务主管 许斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前的产能利用率如何？</p> <p>答：公司各主要产品线均根据客户订单需求，合理有序地组织生产与出货。当前，各产线产能利用率因产品类型及工艺环节差异而有所不同，但整体均处于正常高效的运行区间。公司将持续紧贴市场需求，积极拓展客户资源、扩大订单规模；根据业务情况适配相应产能及综合的供应服务能力，为客户创造更大价值。</p> <p>2、请问公司的核心竞争优势有哪些？</p>

答：唯特偶在国内微电子焊接材料领域稳居领先地位，尤其在锡膏、助焊剂两大细分赛道优势突出。公司的核心竞争力主要体现在三方面：（1）技术优势。自创立28年来，公司始终紧跟行业技术发展趋势，不仅实现产品品类的全面覆盖，更积累了丰厚的技术储备，在产品性能稳定性保障、生产成本精细化控制等关键环节均处于行业前列；（2）客户资源优势。公司迄今合作客户累计超4000家。由于微电子焊接材料行业存在较长的认证周期与较高的市场进入门槛，客户黏性极强，能够为公司持续贡献稳定的营业收入；（3）规模优势。公司上市以来，公司资金实力与人才储备显著增强，整体规模稳居国内同行业优势地位。依托充足的资金与人才支撑，公司不断赋能研发创新、生产效率提升与管理优化，尤其在生产成本控制、研产销协同效率、市场定价话语权等方面，优势愈发凸显。

3、公司三大募投项目中，“微电子焊接材料产能扩建项目”和“微电子焊接材料研发中心建设项目”的投入进度和最新建设状态如何？特别是产能扩建项目预计2027年6月达到预定可使用状态，目前是否按计划推进？产能瓶颈当前的缓解程度如何？

答：截至目前，“微电子焊接材料产能扩建项目”和“微电子焊接材料研发中心建设项目”均按计划正常推进中，有关内容请持续关注公司于巨潮资讯网披露的相关内容。

4、请问公司的产品可以用于先进封装吗？

答：公司生产的微电子焊接材料作为电子材料行业的重要基础材料之一，主要应用于PCBA制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联。公司将持续加大高端微电子焊接材料、半导体

	<p>封装材料、可靠性材料等领域研发与产品迭代，推进激光锡膏、超细粉锡膏等产品在先进半导体封装等新兴领域的渗透应用，为业务增长提供技术支撑。</p> <p>5、请问公司产品在光模块领域是否有应用？有哪些客户？</p> <p>答：在光模块及其部件的生产过程中，锡膏主要应用于三大环节：一是光器件（如TOSA、ROSA）的SMT贴装，二是光芯片封装中的高精度倒装焊（如硅光芯片的微凸点焊接），三是PCBA（印制电路板组件）上其他无源元件的表面贴装。公司的微电子焊接材料等产品可应用于上述应用场景。关于具体客户信息，基于保护客户商业秘密的原则，在符合信息披露监管要求的前提下，公司不单独披露具体客户的业务数据。</p>
附件清单（如有）	
日期	2026年05月21日